

「ハードウェアのシリコンバレー深セン」に学ぶ - これからの製造のトレンドとエコシステム (NextPublishing)



発売日: 2017年11月24日

出版: インプレスR&D

著者: 藤岡 淳一

ページ: 124

PDF

<http://yep.pm/lbyQnP6d5/z2nIP91kf.pdf.rar>